

江苏卓胜微电子股份有限公司

2024 年度总经理工作报告

尊敬的公司各位董事：

2024年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的要求，忠诚勤勉地履行职责，贯彻落实股东（大）会、董事会决议并完成了2024年度各项工作。在此，我谨代表公司管理层向董事会总结汇报2024年度相关工作，具体如下：

一、2024年主要经营情况概述

过去几年受到资本热潮驱动，行业内涌入了大量新进者，在部分技术门槛较低且同质化严重的中低端射频前端产品领域，本土竞争日趋激烈。随着射频前端产品差异化、集成化、高端化需求愈发旺盛，规模更大、产品线更完善、具有更强供应链调节能力的企业将获得更高的市场认可度与青睐，推动企业产品往更高端的产品演进。

作为国内目前射频产业链布局相对完整和领先的企业，公司于报告期内持续深入Fab-Lite经营模式的转化，充分发挥公司的产业化效能优势，发展新质生产力。得益于工艺和技术资源平台的建设，“智能质造”平台的逐渐落地，产品于技术革新、供应链优化、市场拓展等多维度实现突破的空间格局已然向上打开。公司在通过射频前端产品不断在“实战”中“乘势而上”，综合实力日益彰显。

此外，受益于公司自主产线量产优势，公司逐年突破高性能产品市场，公司射频前端模组收入比例逐年增长，销售占比从上年度 36.34%提升至 2024 年度 42.05%，充分彰显了不同应用终端对高性能、集成化的模组的迫切需求。报告期内，公司实现营业总收入 44.87 亿元，较上年同期增长 2.48%；归属于上市公司股东的净利润 4.02 亿元，较上年同期下降 64.20%。公司业绩与上年同期相比有所下滑，其主要原因系：（1）为加快战略落地，芯卓持续加大研发投入和人才储备力度，本报告期研发费用同比增加；（2）随着产品结构变化、芯卓固定资产转固及市场竞争等因素，毛利率同比有所下降。

二、2024 年主要工作回顾

（一）加大研发投入，为发展注入强劲动力，夯实技术根基，于竞争中抢占高

地

依托资源平台的坚实支撑，公司的设计得以与工艺、制造深度融合，打破原有局限，开启了多维度技术演进的全新征程，为公司发展打开多维空间。公司以客户需求和市场演进为导向，技术研发为基础，工艺、材料创新为抓手，资源平台为保障，持续加大研发投入力度，促进产品升级和按计划将产品高效导入产线并实现放量。报告期内，公司研发投入 99,706.70万元，较上年同期增长58.53%。近年来随着公司战略布局的落地，研发投入占营业收入比例呈逐年上升的趋势，2022-2024年度，研发投入占比分别为12.22%、14.37%和22.22%。

与此同时，公司加强针对关键技术和工艺加强专利保护措施，形成公司满足客户差异化需求、开拓模组新市场的重要支撑，公司共计取得142项专利，其中国内专利140项（包含发明专利83项）、国际专利2项（均为发明专利）；21项集成电路布图设计。2024年度共申请专利142项，其中发明专利112项，实用新型专利30项，新增申请主要集中于射频滤波器产品相关板块。

（二）资源高效整合，综合优势不断释放，为各领域发展注入新活力

报告期内，公司在不断巩固并提升原有优势产品市场份额的同时，积极扩大射频模组产品的市场开拓力度。公司突破单一的创新方向，快速形成协同效应，提升资源利用效率，持续丰富滤波器产品的“实战经验”扩大市场覆盖度，公司的供应链控制、产品交付等能力的构建得到显著提升，助力公司模组产品业务深入拓展，有效对抗了诸多外部因素带来的负面压力，资源平台的综合优势逐渐显现。

报告期内，公司对于芯卓半导体产业化项目建设进程已由前期投入步入中期交付阶段。身处射频前端市场淡旺季迹象不显的环境中，公司借助高效资源平台业务模式，力争市场机遇积极扩大滤波器产品市场覆盖度，助力公司模组产品业务深入拓展，有效对抗了诸多外部因素带来的压力，不断提高产品的自主可控能力。在技术创新、供应链管理、生产制造升级、队伍建设和综合管理多维度，打开了向上提升与突破空间，为公司的持续发展注入动力。

在技术研发上，平台所搭载的行业前沿的设计、工艺、制造等多方面技术能力，灵活多维打开向上的创新层，加速技术产品迭代；供应链层面，实施与供应商密切协作，参与关键设备或产品的工艺与技术研究开发与定制；生产制造环节，高精度的自动化设备与智能质检协同，大幅提升产品质量与生产效率；运营流程里，数字

化的深度嵌入，优化资源配置，降低内耗；人才建设中，借助平台的学习与交流模块，为员工提供广阔成长空间，打造高素质团队；综合管理方面，全方位的数据整合与可视化呈现，让决策更科学、管理更精细。

（1）6英寸晶圆生产线

目前公司 6 英寸滤波器晶圆生产线已具备较为完整的生产制造实力，同时在工艺上有了全面的积累和提升，可迅速适应市场需求的变化和技术发展趋势，基本覆盖低、中、高端全类型的产品形态，以交付高质量、高良率、高性能的产品满足客户的多元化、差异化的需求，覆盖更广泛的市场群体。报告期内，6 英寸滤波器产线的产品品类已实现全面布局，具备双工器/四工器、单芯片多频段滤波器等分立器件的规模量产能力，同时集成自产滤波器的 DiFEM、L-DiFEM、GPS 模组等产品成功导入多家品牌客户并持续放量。截止至报告期末，通过芯卓资源平台实现的供应、生产制造、工艺等能力成功在6英寸滤波器晶圆生产线上得到体现，产品良率稳中有进、国产化方案全面推进、工艺流程与操作规范进一步优化、自动化率达到行业头部水平。

（2）12英寸晶圆生产线

报告期内，公司全面开拓并发挥资源平台的深层效益，使12 英寸 IPD 平台正式进入规模量产阶段，L-PAMiF、LFEM 等相关模组产品已全部采用自产 IPD 滤波器。公司12英寸射频开关和低噪声放大器的第一代工艺生产线已实现工艺通线进入量产阶段。同时公司启动了第二代工艺的开发，目前进展顺利。公司12英寸射频开关和低噪声放大器的工艺生产线产品已分别在射频开关、射频低噪声放大器及相应模组集成，覆盖多家品牌客户以及绝大部分 ODM 客户。

截止至报告期末，公司 12 英寸晶圆生产线重要工艺实现从工艺稳定定型至产能逐步提升，目前可实现 5000片/月的产能规模。

（3）先进封装生产线

公司专注布局和投资新的前沿技术，突破工艺技术壁垒，真正对标国际头部企业，为公司构建新的核心竞争力。公司前瞻性地规划了射频前端行业领先的先进封装工艺技术能力，通过领先的异构集成模组化解决方案，满足下一代器件性能、成本需求。例如通过3D堆叠封装形式实现更好的性能和面积优势，最终达成公司产品快速迭代需求及模组化、系统化的高端产品规划，截止至报告期末，公司已有部

分产品采用先进封装技术并获得客户的验证通过。

射频前端高性能模组产品的不断推陈出新与先进工艺架构及器件的支撑迭代紧密相关，通常IDM 的经营模式，能够进行快速高效的生产制造能力的工艺、器件、材料开发和技术迭代，是构建技术壁垒并形成竞争优势的最高效途径。因此，公司着力构建先进射频前端芯片及模组的产研能力和先进架构，集聚平台化资源为客户创造价值，为未来拓展更多的产品品类和行业应用领域提供了更多的可能性。

（三）移动通信与无线连接产品

（1）全国产供应链L-PAMiD产品

报告期内，公司推出了集成 6 英寸滤波器晶圆生产线自产 MAX-SAW 的 L-PAMiD（主集收发模组，集成射频低噪声放大器、射频功率放大器、射频开关、双工器/四工器等器件的射频前端模组）产品，并利用资源平台快速迭代的优势，配合 L-PAMiD 产品的持续优化不断完成产品迭代，以更加灵活迅速的方式和更前端的性能表现响应客户需求，加速产品的市场化进程。该产品是目前业界首次实现全国产供应链的系列产品，作为承载公司未来营收增长的明珠型产品，L-PAMiD 产品已成功通过部分主流客户的产品验证，目前第一代产品进入量产阶段，第二代产品完成技术升级。公司针对 L-PAMiD 产品的研发覆盖全频段，将逐步丰富产品型号，持续布局高价值化的产品矩阵，形成产品战略闭环。

（2）无线连接产品

公司始终保持在移动通信与无线连接产品双通道的研发投入。无线连接方面，报告期内公司在手机WiFi FEM中取得进展。截至报告期末，公司WiFi7模组产品已成功实现规模量产。

（四）数字化管理和建设

公司持续完善信息安全体系，多措并举保障其顺利运行，并持续优化，保障公司信息设备和数据安全。报告期内，公司将信息化管理覆盖产品研发、生产制造、质量管理、销售等各个环节中，从而起到信息共享、数据协同的作用，确保数据的准确性和可靠性，提高人员工作效率和准确率。公司正不断通过优化财务、运营、销售、项目、仓储等各部门的业务流程和资源，整合资源配置，进行可视化过程管理和精细化成本追踪，逐步为降本、增效提供可靠的数字化支撑。同时，公司进行

全面的科学化成本管理，全链条成本管理与精细化成本管理并行，给资源平台带来持续创新驱动。

公司针对自建产线，将数字化管理贯穿设备管理、生产执行、运营管理、产品全生命周期，实时掌握生产信息，实现生产自动化，从而提升生产效率和设备利用率。

（五）环保、安全生产

环境保护方面，公司高度重视环境保护工作，积极进行安全环保风险识别、体系制度完善等各项工作，定期对周边环境进行监测，严格遵守环境风险防范要求。

安全管理方面，公司对生产过程中会涉及的化学品实施全生命周期安全管理，制定并完善相关制度文件，规范管理流程，确保化学品管控有章可循。与此同时，公司设置了多项安全应急设施，定期开展安全生产专项检查，通过隐患排查确保闭环改善。公司通过“安全月”、“消防月”、应急演练、举办主题培训与安全文化活动等方式，着重提高全员安全意识和应急技能，培养全员安全素养，确保各项安全管理措施得到有效落实。

三、2025年工作重点

结合公司战略发展的目标及市场环境，2025年公司将围绕以下重点展开工作：

（一）不断完善产品线布局

公司将秉持以客户需求为核心原则，持续推进核心技术及研发能力的创新与突破，逐步完善射频产品线的布局。2019年，公司实现了射频前端模组从无到有的突破；从2020年至今，公司产品从分立器件到模组逐步丰富，近几年射频模组销售占比也逐年提升。未来，公司将进一步完善产品布局，聚焦高端模组产品的研发设计及工艺能力，持续追求高价值化、差异化、成本化的深度布局，为公司产品应用领域拓展更多的可能性，并总结吸取平台资源的积累与沉淀，为公司带来长期可持续发展的核心竞争力，打造更坚实的壁垒与“护城河”。

（二）加大高端模组产品市场推广，纵向拓展市场领域

公司将依托芯卓自建产线的特色工艺，深入研究通信、消费电子等主要应用领域，密切关注人工智能相关等新兴领域，明确不同应用场景对产品需求的差异，制定针对性的市场推广策略，精准触达目标客户群体。同时，公司亦组织专业技术团队，为客户提供不同产品的技术解决方案，以技术实力赢得客户信任。随着公司进

一步向高端应用迈进，未来公司将以高端、个性、差异化产品为首要产品发力点，以点及面促进高端模组产品的口碑传播与市场渗透。立足于前期经营积累，公司具备长期稳定且优质的客户资源，将进一步深化与下游应用客户的合作伙伴关系，历练自身内功，在纵向应用领域发掘更多的机会。

（三）贯彻产品方案最优解原则，横向发展产品线，不断强化综合能力

公司将始终贯彻落实产品方案最优解原则，在产品设计、开发及优化等各个阶段，通过有针对性地考虑不同市场群体的需求、技术可行性、成本效益、市场竞争等多方面因素，运用科学的方法和工具，寻求能够实现产品整体价值最大化的解决方案。目前，公司向上突破的格局已打开，将发挥资源平台内外的联动力，推动产线加速形成规模效应，锻造个性产品、特色工艺、先进制造、可控成本等长久核心竞争力，推动公司实现综合实力提升在内循环中完成闭环，并将在射频行业的沉淀与积累过程中，关注前沿新兴行业，横向扩展更全面的产品线。

（四）追求全面和精细化管理并行

公司将持续寻求科学管理适应可持续发展的路径。在资源积累与沉淀的过程中，公司将不断提升管理能力，选择全链条管理与精细化管理并行的管理方式，以适应当下快速发展的节奏。从高层决策到基层执行，从市场、研发、生产到销售等，全链条管理涵盖重要业务环节，形成互锁机制确保各业务管理零死角，促进各部门之间的沟通与协作。

在精细化管理方面，公司关注流程与标准的完善，注重指标量化。将全面管理和精细化管理的要求融入到组织的管理体系中，明确全面管理的范围和内容，以及精细化管理的标准和方法，使两者有机结合。同时，加强内部的培训与沟通机制，利用信息技术实施运营调控、及时调整管理策略和方法，不断优化管理流程和标准，使全面和精细化管理水平不断提升

四、总结

2025年亦是公司处于发展历程中极具挑战的阶段，面对国外地缘政治冲突、市场竞争激烈及未知的挑战，公司从自身做起，在“勤拙信和”的价值观中，强化“拙”背后的专精能力，聚焦公司芯卓产业化建设项目和科学管理方法，巩固并突破关键产品和工艺的智能制造能力，持续依托自建产线完善产品线布局并向更多市场有序推广高性能模组产品，在保证手机市场现有规模为基础的前提下，在下游应用领

域将产品推介至更多非手机领域中，实现行业瓶颈结构性突破。除此之外，公司将借助高效资源平台业务模式，纵横拓展产品线及产品应用领域，以特色工艺的迭代来提升竞争力，以资源平台建设重新定义业务结构，以多维度建设推进客户战略，力争推进营收增长点的实现。

江苏卓胜微电子股份有限公司

总经理：许志翰

2025年3月31日